



## Evaluierungsboards für SuperSpeed USB-zu-FIFO Bridge ICs

*HSMC- und FMC-Anbindung erleichtert Einbindung in FPGA-basierte Designs*



Dazugehöriges Bildmaterial steht in  
hoher und niedriger Auflösung zum Download [bereit](#)

**9. September 2015** - Um den breiten Einsatz seiner kostengünstigen und einfach implementierbaren USB-Schnittstellentechnik der nächsten Generation voranzutreiben, bietet FTDI Chip eine neue Serie von Evaluierungs- und Entwicklungsmodulen an. Die FT600/1Q USB 3.0 SuperSpeed ICs des Unternehmens befinden sich bereits in der Serienfertigung, und ab sofort stehen dafür die UMFT60XX-Module bereit. Vier Modelle bieten unterschiedliche

FIFO-Bus-Schnittstellen und Bitbreiten. Mit den Modulen besteht voller Zugriff auf die Betriebsparameter der FT600/1Q-Bausteine, um eine Evaluierung und den Anschluss an externe Hardware wie FPGA-Plattformen der führenden Hersteller vornehmen zu können.

Mit den Abmessungen 78,7 mm x 60 mm bieten das UMFT600A und UMFT601A jeweils eine HSMC-Schnittstelle (Highspeed Mezzanine Card) mit 16- bzw. 32-Bit breiten FIFO-Bussen. Das UMFT600X und UMFT601X weisen die Abmessungen 70 mm x 60 mm auf und bieten FMC-Stecker (Field-Programmable Mezzanine Card), ebenfalls mit 16- bzw. 32-Bit breiten FIFO-Bussen. Die HSMC-Schnittstelle ist kompatibel zu den meisten FPGA-Referenzdesign-Boards von Altera, während der FMC-Stecker die gleiche Funktion in Bezug auf Xilinx-Boards liefert.

Die UMFT60xx-Module sind kompatibel zu den Datenübertragungsraten bei USB 3.0 SuperSpeed (5 GBit/s), USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) und USB 2.0 Full Speed (12 MBit/s). Sie unterstützen zwei parallele Slave-FIFO-Bus-Protokolle mit einer Daten-Burst-Rate von 400 MByte/s. Der Mehrkanal-FIFO-Modus kann bis zur vier Logikkanäle handhaben. Hinzu kommt ein 245-Synchron-FIFO-Modus, der einen optimierten Betrieb ermöglicht.

„Wir haben früh erkannt, dass USB-3.0-Designs anstelle von MCUs auf programmierbarer Logik aufbauen, was Embedded-Entwicklern zahlreiche Vorteile bietet“, so Fred Dart, CEO und Gründer von FTDI Chip. „Damit lassen sich die Stückkosten unter Kontrolle bringen und das Schreiben/Kompilieren von umfangreichem C-Code vermeiden.“ Dart weiter: „Wir arbeiten eng mit bedeutenden Unternehmen im FPGA-Bereich zusammen, um diese technisch und finanziell effizientere Methode zur Einbindung von USB 3.0

voranzutreiben. Die neuen Module sind kompatibel zu den meisten FPGA-Entwicklungsplattformen, wie sie von Xilinx oder Altera angeboten werden.“

Weitere information unter: <http://www.ftdichip.com/ft60x>

### **Über FTDI Chip**

FTDI Chip bietet innovative Halbleiterlösungen, mit denen sich die Interaktion mit heutiger Technologie vereinfacht. Mit seinem Konzept „Design Made Easy“ bietet das Unternehmen hochentwickelte, funktionsreiche, robuste und einfach anwendbare Plattformen. Damit lassen sich Elektronikdesigns mit höherer Leistungsfähigkeit, weniger Peripherie, geringerer Stromaufnahme und kleinerem Platzbedarf auf der Leiterplatte entwickeln.

FTDI Chips etabliertes und kontinuierlich erweitertes USB-Angebot (Universal Serial Bus) umfasst die Marken R-Chip, X-Chip, Vinculum und die H-Serie. Neben Host- und Bridge-ICs zählen dazu auch hochintegrierte Systemlösungen mit integriertem Mikrocontroller (MCU). Die Embedded Video Engine (EVE) Grafikcontroller vereinen Display-, Audio- und Touch-Funktionen auf einem Chip. Dieser einzigartige Ansatz verringert die Entwicklungsdauer und die Materialkosten neuer Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI, Human Machine Interface). FTDI Chip bietet auch differenzierte, auf Geschwindigkeit optimierte MCUs mit erweiterten Datenanbindungsmöglichkeiten. Diese AOCs (Application Oriented Controller) richten sich an Anwendungen, die höhere Rechenleistung und einen effizienteren Betrieb erfordern.

FTDI Chip ist ein Fabless-Halbleiterhersteller, der mit weltweit führenden Foundries zusammenarbeitet. Der Sitz des Unternehmens befindet sich im schottischen Glasgow; Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen finden sich in Glasgow, Singapur und Taipeh (Taiwan). Vertriebsniederlassungen und technischer Support ist zudem in Glasgow, Taipeh, Portland (Oregon, USA) und Schanghai (China) ansässig.

Weitere Informationen unter: <http://www.ftdichip.com>

### **For further information and reader enquiries:**

Steven van der Wolf - FTDI Chip

Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow, G41 1HH, UK

Tel: +44 (0) 141 429 2777 Fax: +44 (0) 141 429 2758

E-mail: [marketing@ftdichip.com](mailto:marketing@ftdichip.com)

**Issued by:**

Mike Green - Pinnacle Marketing Communications Ltd

Tel: +44 (0)20 84296543

E-mail: [m.green@pinnaclemarcom.com](mailto:m.green@pinnaclemarcom.com)

Web: [www.pinnacle-marketing.com](http://www.pinnacle-marketing.com)

**September 2015    Ref: FTDIPR60/GER**